

2025年7月30日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料WG

主査 藤尾侑輝

副査 上原雅人、蔭浦泰資

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム 令和7年度 第1回 センシング材料WG講演会のご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本WGでは、産総研が開発する世界トップクラスのセンシング材料：窒化物薄膜(ScAlN、GaScN等)、ダイヤモンド、湿式酸化物薄膜等の最新の研究開発動向(材料開発、材料特性、製造方法)、社会課題に対する応用展開に関して、産総研、大学、企業の研究者を交えた議論を行っています。今回の講演会では、湿式酸化物薄膜に焦点を当て、高密度プラズマにより薄膜を形成する大電力パルスマグネトロンスパッタリング(HiPIMS)に精通した講師の先生から話題提供をいただき、スパッタリング、蒸着等のドライプロセスの成膜法に対して、湿式酸化物薄膜製造法の優位性や課題、応用展開について議論させていただきたく、第1回センシング材料WG講演会を開催いたします。ご出席宜しくお願い致します。

敬具

記

日時：2025年8月20日(水) 10:00~11:35 (9:45 受付開始)

会場：Microsoft Teamsを活用したオンライン会議

申込締切：2025年8月15日(金)

10:00~10:05	開会挨拶	センシング材料WG 主査 藤尾 侑輝
10:05~10:55	招待講演「HiPIMSによる高密度プラズマ制御と薄膜材料設計の新展開」 東京都立大学 システムデザイン学部 機械システム工学科 准教授 清水 徹英 先生	
10:55~11:20	招待講演「溶液プロセスを用いて作製したZnO膜の機能から構造を考える」(仮題) 産総研 センシング技術研究部門 主任研究員 長瀬 智美	
11:20~11:30	総合討論	
11:30~11:35	閉会挨拶、事務連絡等	センシング材料WG 主査 藤尾 侑輝

※プログラムは変更する可能性があります。

※個人情報、コンソーシアム活動及びセンシング技術研究部門の広報活動に限定して使用させていただきます。

お問い合わせ先：

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料WG事務局

(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

E-mail: M-stri-SenTePack-material-ml@aist.go.jp